

與被投資公司議合互動實例

緣 IC 載板為承載晶片用途，主要用來連結晶片與其他晶片或 PCB 等線路，相較 PCB 具有更高精度製程與要求，其製程中所採用化學品與設備相對更為複雜，IC 載板在整體晶片產業具有重要性。

因此，本公司經理人與研究員於拜訪台灣某 IC 載板廠商時，曾與該公司當面溝通有關載板製程複雜且具有高危險性，製程中容易發生火災，造成工安意外而恐進一步造成員工傷害，意即工安問題也是評估 ESG 等重要環節，其中牽涉環境汙染與員工安全問題。

因本公司研究團隊就該公司在工安預算與污染處理等問題持續進行溝通，被投資公司表示將增加相對執行預算以減少工安事件發生，短期內雖可能降低部分獲利，但對於工安事件之減少應有更大助益，也在 ESG 評分中較易提高，且可以提高該公司企業社會形象，落實企業社會責任之履行。